

证券代码：300656

证券简称：民德电子

深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-13

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（线上会议）
参与单位名称	前海开源基金、景顺长城基金、平安基金、中海基金、中邮基金、Kontiki Capital、Strategic Vision Investment、野村资管、英大保险资管、国华兴益保险资管、杭州弈宸基金、开宝资产、金之灏基金、深圳前海珞珈方圆资产、上海趣时资管、杭州玺岸投资、上海肇万资管、深圳德瑞丰投资、长金投资、上海朴易资管、仁桥资产、磐厚动量资管、火神投资、中信建投、中信证券
时间	2022年12月6日—16日
地点	公司会议室、线上会议
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：高健 证券事务代表：陈国兵
投资者关系活动主要内容介绍	<p>首先介绍了公司近期的经营情况，随后就投资者关心的问题进行了交流。</p> <p>一、公司近期经营情况</p> <p>民德电子是国内少有的在功率半导体全产业链关键环节均有布局、拥有自主可控供应链的上市公司，随着各环节产能的逐步释放，公司功率半导体业务将步入快速增长通道。</p> <p>公司业务方面：条码业务，今年因海外市场消费疲软、物流运输不畅等原因，条码业务在海外的销售与去年同期相比有所下滑，但在国内市场方面，公司条码设备在新能源汽车、电池等等高端制造领域增长迅速，条码业务全年有望保持平稳发展。</p> <p>功率半导体业务，1、功率半导体设计公司广微集成，目前主要在售产品 MOS 场效应二极管，因受限于产能，销售有所下降。2021 年广微集成的上游晶圆代工、硅片供应商多次涨价，2022 年供应链成本仍未有降低，但广微集成产品的销售价格和毛利率</p>

仍保持稳定，待后续主要供应链切换至公司参股上游供应链企业，并逐步销售封装成品后，产品毛利有进一步提升的空间，产能也将大幅提升；广微集成在 12 英寸代工厂推出的 SGT-MOSFET，目前已开始批量出货，明年将持续加大出货量。

2、晶圆代工厂广芯微电子的项目建设进度正常推进，预计明年一季度末通线；目前项目机电安装工作进展顺利，本月初已完成洁净室正压送风节点，计划本月下旬设备开始陆续进场安装调试。近期，广芯微和丽水高质量产业基金签订增资协议，累计获得丽水当地政府基金 1.8 亿元的增资。

3、超薄片背道代工厂芯微泰克，项目已于 12 月 3 日正式动工建设，预计明年三季度通线量产。广芯微电子和芯微泰克将为广大功率半导体设计公司提供硅基及碳化硅功率半导体器件定制化代工+超薄片制程全套解决方案。

4、硅片原材料企业晶睿电子，硅基外延片产能在持续扩产中，单日产能和产值不断创新高；二期智能感知系统应用特种硅片项目已在进行内部机电安装，预计春节前后可建成投产。晶睿电子近期开展了新一轮融资，意向认购金额大幅超过拟融资金额，估值也较前轮融资大幅提升，本轮融资的完成，为晶睿电子带来更充足的资金和更丰富的产业链资源；为提升公司资金使用效能，公司以 4800 万元的价格转让了晶睿电子 2.087% 的股权，公司的对外投资初显成效。晶睿电子的快速发展，得到了产业和资本的广泛认可，并进一步夯实了公司 smart IDM 生态圈的基础。

二、主要问题和回复

问题 1：公司条码业务的增长方向和未来展望如何？

答：公司条码业务将继续加大开拓工业端市场，随着工业物联网、数字化、智能化等高端制造业的发展，中高端条码识别产品需求在不断增长，特别是今年以来，公司条码识别设备在新能源汽车、储能电池等领域销售增长迅速；同时，公司也将根据市场需求不断推出新产品，并加大海外市场开拓力度。预计未来几年，公司条码业务将保持稳定增长。

问题 2：晶圆代工厂广芯微电子目前的建设进度如何，规划产能是多少？

答：目前广芯微电子一期项目建设进度一切正常，团队、设备、资金等核心要素均已就位，预计到明年一季度末通线。一期项目以 6 英寸硅基晶圆代工为主，初期规划产能为 10 万片/月；鉴于芯微泰克后续将承接广芯微电子的超薄片背道代工环节，广芯微电子只需要保留基本的背道工序，空出的空间可以进一步扩充广芯微电子的正

面工艺产能，因此，在同等投资规模情况下，广芯微电子一期项目的月产能预计可提升至13-15万片。

问题 3：广芯微电子下游客户情况怎样，能否消化一期产能？

答：广芯微电子致力于成为国内晶圆代工厂的典范，定位中高端功率器件的晶圆代工业务。中高端功率器件代工产能及超薄片背道代工产能均为国内稀缺资源，且广芯微电子的核心团队成员平均拥有二十年以上从业经验和丰富的业界资源，目前已有充足的客户储备。首先，广芯微电子将优先为 smart IDM 生态圈内的设计公司（广微集成、江苏丽隼半导体）提供晶圆代工产能保障；此外，广芯微电子已经筛选并确定若干家技术能力优秀的功率器件设计公司作为一期产能代工客户；因此，广芯微电子下游客户需求可充分覆盖一期产能。

问题 4：公司在碳化硅产品方面有何规划？

答：公司在功率半导体硅基器件和碳化硅器件领域均是基于供应链自主可控的战略进行布局。公司在碳化硅功率器件方面已有丰富、成熟的技术储备和团队储备，核心技术团队长期从事硅基功率半导体及第三代功率器件的研发及产业化经验，主导或参与过多项碳化硅功率器件研发和产业化项目。

目前公司所投资企业已覆盖包括外延生产、晶圆加工、超薄片背道减薄、芯片设计等关键环节，基本完成供应链核心环节布局，明年包括碳化硅外延片、碳化硅器件等产品都将陆续量产。后续公司将基于自主可控供应链，并结合市场情况，逐步推出更多的碳化硅功率器件系列产品。

问题 5：公司在功率半导体的核心优势体现在哪里？

答：功率半导体器件是特色工艺，需要在设计、制造、原材料等方面进行特色化定制，以及产业链上下游密切配合，因此，在关键环节具备自主可控供应链，是成为优秀功率半导体企业的必由之路，也是公司的核心优势体现所在。公司致力于打造功率半导体领域 smart IDM 生态圈，近几年已先后完成了在功率半导体设计、原材料硅片、晶圆代工、超薄片背道减薄等关键环节的布局，未来公司将全力支持所投资功率半导体产业链企业建成投产并持续扩产，充分释放 smart IDM 生态圈的强大产业链协同效益，不断提升公司核心竞争力。

问题 6：公司对功率半导体行业未来发展走势如何看？

答：今年以来，受消费端市场下滑等因素影响，功率半导体市场的分化愈加明显，

	<p>消费类产品需求持续走低，而以新能源汽车、光伏、储能电池等为代表的工业和能源领域，功率器件需求仍保持高景气度，同时中高端功率器件对进口依赖度依然较高。</p> <p>公司的功率半导体产品坚持“面向进口替代，面向工业和能源市场”，未来几年，在“碳达峰、碳中和”的国家战略下，一方面，功率半导体市场总体需求在持续快速增长，尤其针对于应用在工业和能源领域的中高端功率器件；另一方面，伴随国内功率半导体产业链企业整体技术水平和供应链基础不断提升，国产替代的比例会逐步提高；因此，国内功率器件市场仍处于一个非常好的发展机遇期。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022-12-16